

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

470

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

17.04.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	288		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
A-RS-FR4-ML-0.71mm-035+035-TG150-HF	50200660	35	L2	4
		710		
		35	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	288		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	7

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1392 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik